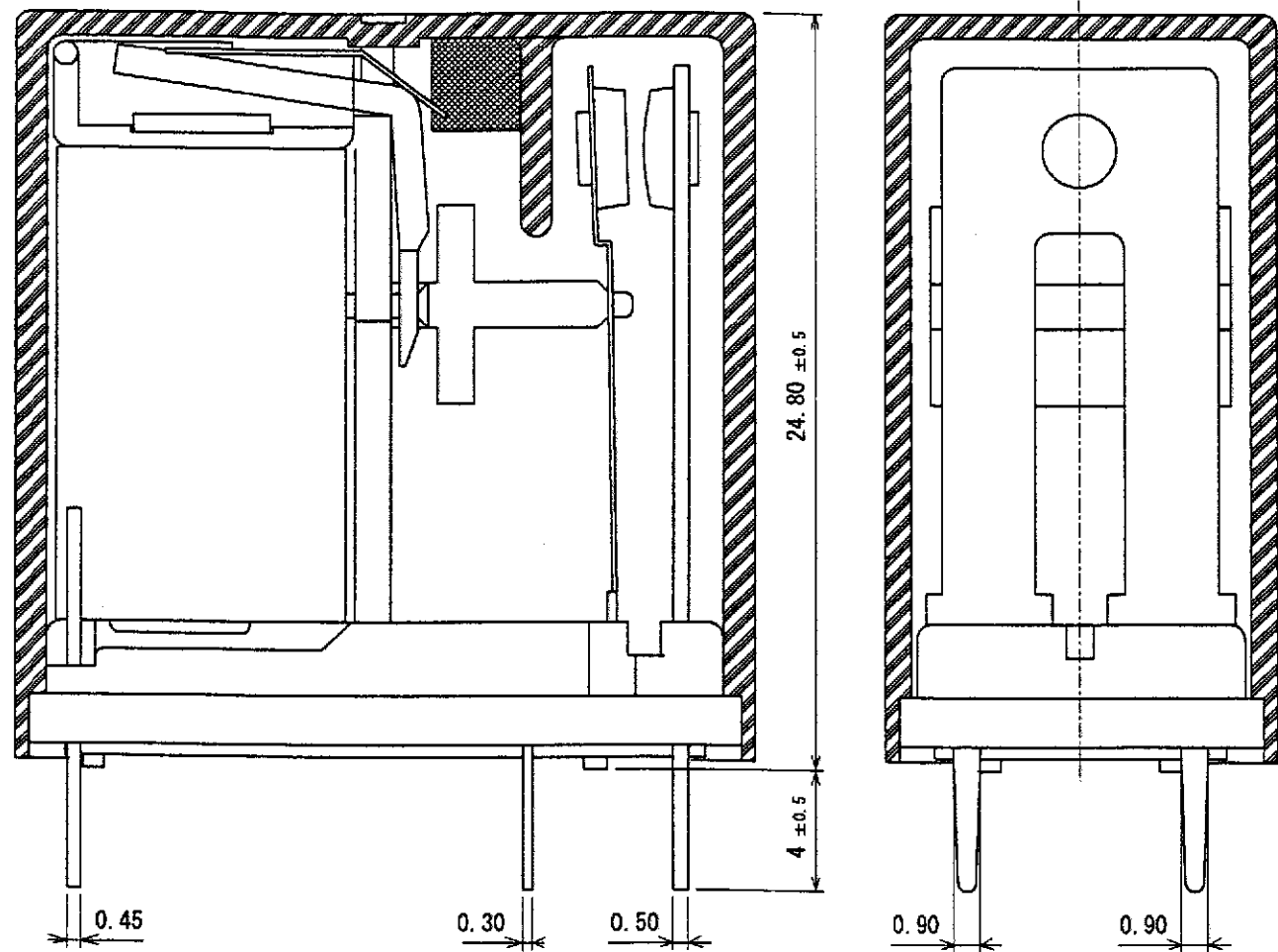
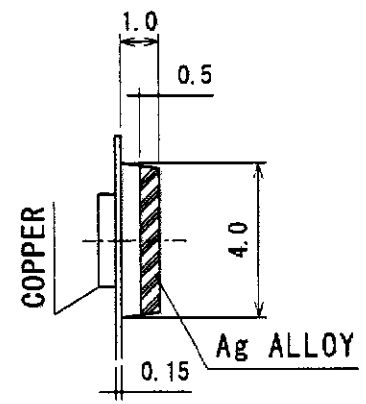


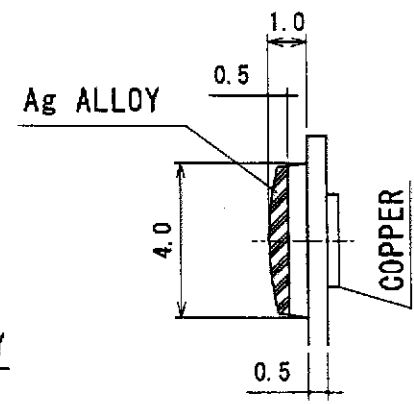
1 . . .
 2 . . .
 3 . . .



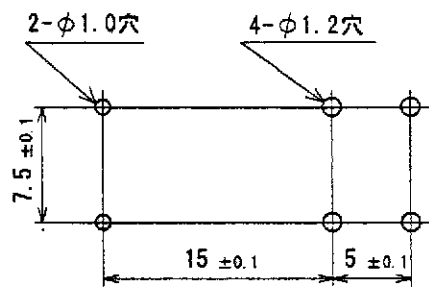
C-CONTACT DETAIL (5/1)



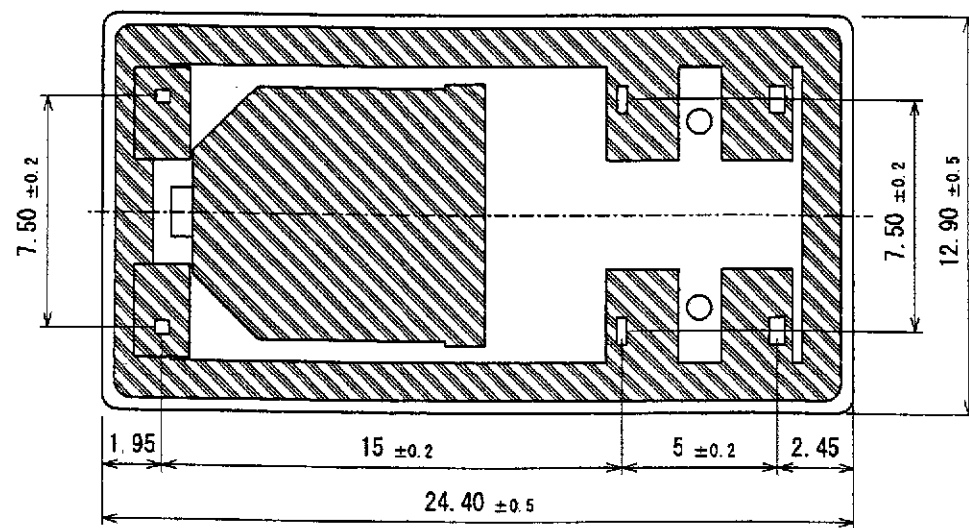
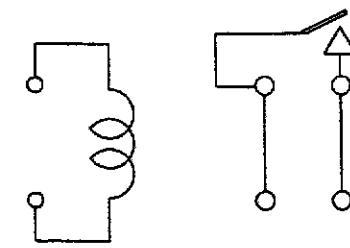
S-CONTACT DETAIL (5/1)



DRILLING DIAGRAM (2/1)

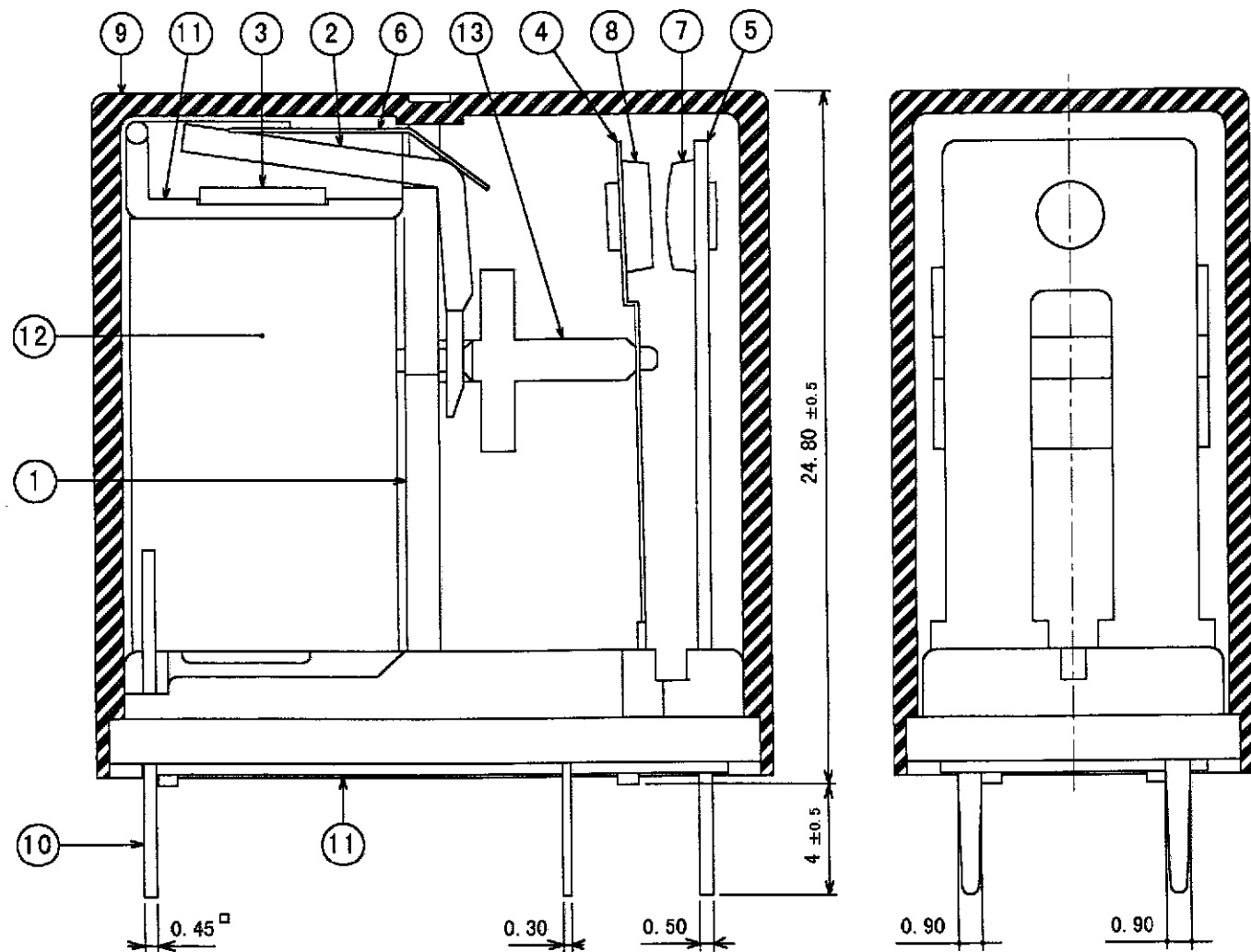


CONNECTION DIAGRAM

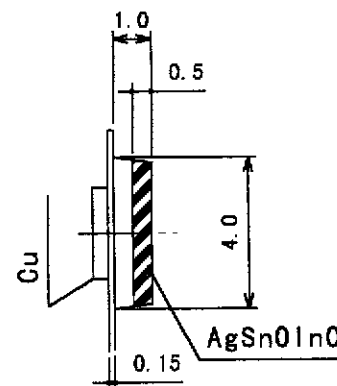


1 4	RESIN	EPOXY			
1 3	CARD	PA66		94V-0	CM3004G-30 TORAY INDUSTRIES INC UL File NO. E41797
1 2	MAGNET WIRE	U. E. W			E CLASS 120° C
1 1	BOBBIN	P. B. T		94V-0	#5010GN6-15 MITSUBISHI CHEMICAL UL File NO. E53664(M)
1 0	COIL-TERMINAL	C. P WIRE	SOLDER DIP		0.45x0.45
9	CASE	P. B. T		94V-0	#5010GN6-15 MITSUBISHI CHEMICAL UL File NO. E53664(M)
8	C-CONTACT	AgSn0In0			See CONTACT DETAIL
7	S-CONTACT	AgSn0In0			See CONTACT DETAIL
6	HINGE SPRING	PBS			t 0.15
5	M-TERMINAL	Cu-Fe ALLOY	SOLDER DIP		t 0.5
4	C-TERMINAL	Be-Cu	SOLDER DIP		t 0.15
3	CORE	S-10R	ANNEAL FNM2		φ 3.5
2	ARMATURE BRACKET	SPCC	ANNEAL FNM2		t 1.0
1	FRAME BRACKET	SPCC	ANNEAL FNM2		t 1.2
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH	UL-94	NOTES
DRAWN	MCP		SCALE	TYPE:	
CHECK			4	OSZ-SS/SH-1** DM8	
APPROVE	X NARA		1		
				ISSUE:	1989, 11, 17
				DRAWING NO.:	
				U-1216	

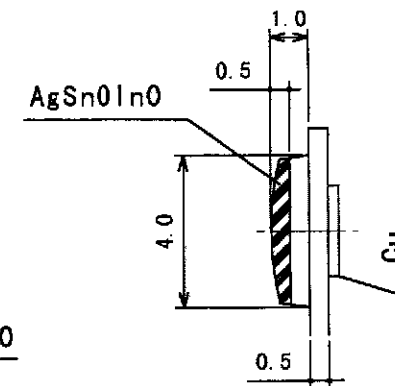
△ 1 . . .
△ 2 . . .
△ 3 . . .



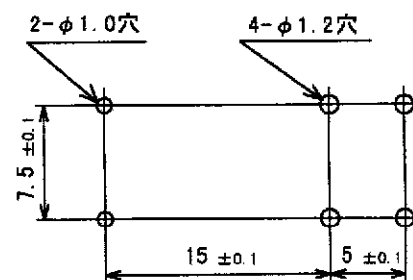
#8 可動接点詳細図 (5/1)



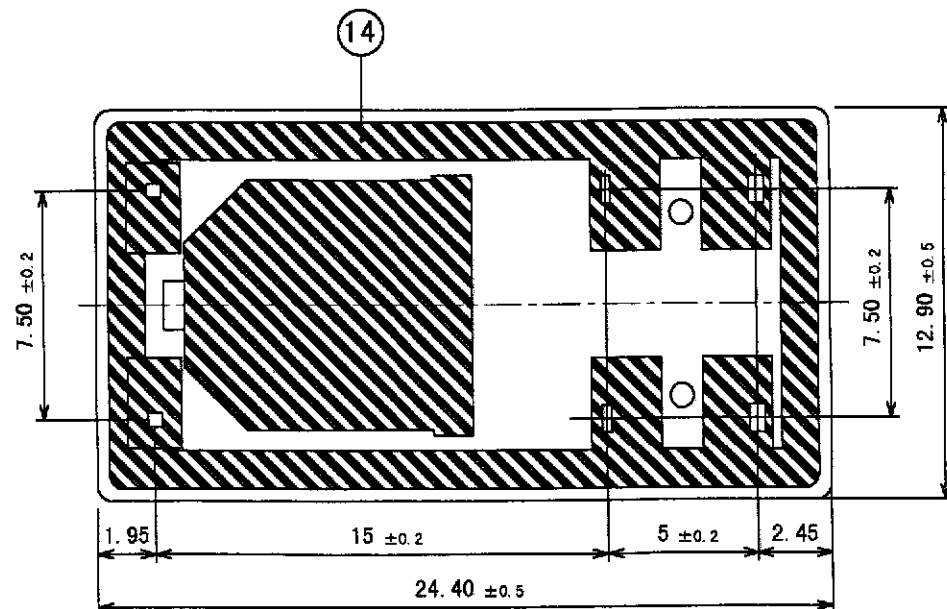
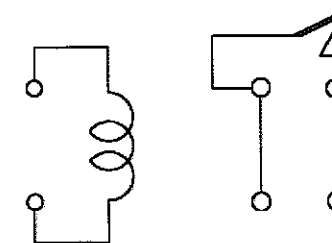
#7 固定接点詳細図 (5/1)



プリント基板加工図 (2/1)
(銅箔面より見た図)



接続図
(端子側より見た図)



14	シール剤	エポキシ			
13	カード	PA66	94V-0	CM3004G-30	
12	線材	U.E.W			
11	ボビン	P.B.T	94V-0	5010GN6-15	
10	コイル端子	C.P線	予備半田	0.45×0.45	
9	ケース	P.B.T	94V-0	5010GN6-15	
8	可動接点	AgSn01n0		φ4.0×1.0	
7	固定接点	AgSn01n0		φ4.0×1.0	
6	ヒンジスプリング	PBS			
5	A端子	高導電率合金	予備半田		
4	C端子	Be-Cu	予備半田		
3	鉄芯	STEEL	アニール 銅下Niメッキ		
2	アマチュア	STEEL	アニール 銅下Niメッキ		
1	ヨーク	STEEL	アニール 銅下Niメッキ		
分号	名 称	材 質	処 理	自 消 性	そ の 他
作 図	検 図	確 認	尺 度	4/1	品 名
					OSZ-SS/SH-100DM8
					用途
					発行
					1990年 7月 3日
					図番
					U-1236-00